

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

И.Шахнович, М.Шейкин. Productronica 2013.
Мозаика новых решений №1, с.26

В.Майская. Конференции IEDM и ISSCC.
Лучшие из лучших №2, с.32

Н.Елисеев. EMBEDDED WORLD-2014 – встраиваемые
системы в полном объеме №3, с.30

Конференция "Светодиоды: чипы, продукция, материалы,
оборудование" №4, с.112

Е.Суворов. SEMICON – эффективная площадка для
развития бизнеса №5, с.146

И.Шахнович, Г.Логинова. SMT Hybrid Packaging 2014:
в фокусе – малый и средний бизнес №5, с.176

М.Шейкин. Российская конференция IPC. Точки зрения №7, с.130

М.Шейкин. Революция 4.0. Послесловие к IX
международному симпозиуму Асолд-2014 №8, с.138

ИНЖЕНЕРУ №1, с.101, 120, 132; №2, с.76, 128, 136; №3, с.86;
№4, с.83; №5, с.73; №6, с.31, 63, 88, 114, 132; №7, с.47, 63, 102; №8, с.65, 71, 78

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В.Озеров. Законодательные инициативы возникают,
когда общаешься с профессионалами №1, с.10

Н.Ковалев. "Диполь" – поставщик знаний №2, с.12

В.Разумов. Передовое технологическое оборудование:
мы делаем Это №3, с.10

А.Гриневич. Дайте время – и мы догоним мировых
лидеров №3, с.181

Дж.Лиз. Микроконтроллеры Freescale – легче, быстрее,
универсальнее №4, с.10

М.Рыбаков, М.Цветков. Корпорация Intel: быть во всем,
что вычисляет №4, с.18

Н.Нишизава. Yamaha: мы уже успешны, но хотим
большого №4, с.159

С.Хохлов. Итоги деятельности радиоэлектронной
промышленности в 2013 году и основные
задачи на 2014 год №5, с.10

Расширенное совещание руководителей предприятий
радиоэлектронной промышленности
по итогам 2013 года №5, с.16

Ф.Пале. Мы предлагаем решения для всех №5, с.171

Д.Велеславов. Достигнут цели, нельзя останавливаться №6, с.12

Ф.Бозе. Наше кредо – максимальная гибкость №5, с.169

Д.Беннет. Мы можем то, чего не могут другие №5, с.180

Г.Сене. Keysight Technologies: что в имени? №7, с.10

Й.Франке. 3D-MID сегодня и завтра №7, с.125

Э.Старклофф. Лучший ответ на современные вызовы –
открытые платформы №8, с.10

С.Хохлов. Перспективы развития отечественной
радиоэлектронной промышленности №8, с.18

Инновационные технологии радиоэлектроники –
регионам России. 13-я отраслевая
научно-техническая конференция №8, с.24

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

Новинки Agilent Technology/
Keysight Technologies №1, с.118; №5, с.80; №6, с.130; №7, с.104

Источники-измерители производства
компании Keithley для испытания мощных
полупроводниковых приборов №1, с.122

Н.Лемешко. Осциллографы R&S RTM: измерение
площади знакопеременных импульсов №2, с.130

О.Казакевич, С.Зайченко, В.Егоров.
Измерительные системы стандарта AXIe – решения
компании Test Evolution №3, с.112

Б.Роланд. Осциллографы R&S RTO – анализ
характеристик источников питания №5, с.82

К.Делвизис. Приборы для поколения "Y": от смартфонов
к осциллографам №5, с.88

С.Доллингер. Тестирование микросхем – решение
компании Advantest №6, с.128

Н.Елисеев, И.Шахнович. Модульные приборы
компании Keysight – компактные, производительные,
универсальные №8, с.106

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И МИКРОПРОЦЕССОРЫ

М.Миенкина, А.Головлев. Kinetis M.
Микроконтроллеры для измерительных устройств №4, с.116

В.Майская. Новые высокопроизводительные
микропроцессоры. Все разнообразнее и интересней №5, с.28

Н.Королев. Компания Atmel: новые микроконтроллеры
на ядрах Cortex-M №5, с.42

И.Романова. Компания Freescale Semiconductor.
Микроконтроллеры семейств Kinetis и процессоры i.MX 6 №5, с.48

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

М.Шейкин. Российские суперкомпьютерные технологии.
Проблемы и перспективы №1, с.114

НОВОСТИ №1, с.20; №2, с.22; №3, с.22;
№5, с.24; №6, с.24; №7, с.22

И.Шахнович. Создана секция радиоэлектронной
промышленности при Совете Федерации РФ №4, с.28

А.Циркунова. Стратегический резерв. Завершился
первый ежегодный конкурс научно-технических работ
"Инновационная радиоэлектроника" №4, с.38

А.Стефанова. Развитие российской радиоэлектроники:
законодательные вопросы №8, с.40

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- В.Громов.** Металлокомпозитные корпуса с полостью – альтернатива металлокерамическим корпусам микросхем и полупроводниковых приборов №2, с.106
- П.Кох.** Выключить свет – включить мини-пржектор №3, с.60
- А.Багдасарян, С.Багдасарян, В.Днепровский, Г.Карапетьян, С.Николаева.** Малогабаритные радиочастотные идентификационные метки на ПАВ. Расширение функциональных возможностей №3, с.70
- М.Шейкин.** Российскому рынку – российскую продукцию. Новые технологии ОАО "ЗПП" №4, с.124
- И.Баранник, Ю.Белогубов, Н.Иванов.** Центр микросистемотехники. Передовые инженерные решения ... №4, с.130
- Ю.Муров.** Унифицированный ряд теплоотводящих БНК: конструктор для разработчиков мощных радиоэлектронных систем №5, с.94
- Н.Василенков, А.Максимов.** Новые корпуса компании "ТЕСТПРИБОР" – эффективная защита от радиации №6, с.154
- А.Нисан, С.Бонапартов.** Аэрозольная печать: технология и варианты применения №8, с.112

ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

- А.Власов.** Установщики Europlacet – настоящее для технологий будущего №2, с.190
- Е.Матов.** Yamaha Motor IM. Достигая наивысшего качества №2, с.196
- А.Любимцев.** Паяльник в законе. Как отличить поддельное оборудование Hakko? №6, с.186

ПОРТРЕТ ФИРМЫ

- С.Сорокин.** Компания EA Elektro-Automatik в России №2, с.31

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- В.Ефремов.** Системы видеонаблюдения реального времени – современные решения №7, с.92

РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА

- И.Шахнович.** Контрактное производство 3D-MID: когда в Швейцарии дешевле, чем в Китае. Визит в компанию Sisog №2, с.111
- И.Шахнович.** Производство, где нет контролеров – это возможно. Визит в компанию Comax №3, с.48
- И.Шахнович.** Источники вторичного электропитания: российская продукция из российских компонентов. Визит в компанию ОАО "НПП "ЭлТом" №4, с.42
- И.Шахнович, М.Шейкин.** Массовое многономенклатурное производство в России. Визит в компанию "Болид" №4, с.167
- И.Шахнович.** Если в государстве нет электроники – у него нет будущего. Визит в центр "Нано-технологии" НИЯУ "МИФИ" №7, с.80

- И.Шахнович.** Производство электрических жгутов: эффективно, технологично, недорого. Визит в компанию "Икар Плюс" №8, с.118

РЫНОК ДИСТРИБУЦИИ

- А.Эскувель, Д.Дорофеев.** Сотрудничество компаний Cree и Макро Групп – новый вклад в развитие силовой электроники в России №1, с.80
- И.Шахнович.** Корпорация Fairchild Semiconductor заключила дистрибуторское соглашение с компанией "Аргуссофт" №4, с.50

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОТЕХНИКА

- В.Беляев.** Погружение в суперреальность. По результатам симпозиума SID 2014 №6, с.32
- В.Майская.** Светодиодная технология. Украсим жизнь светом №6, с.46
- М.Червинский.** Новая продукция компании Cree: возможности для разработчиков систем освещения расширяются №6, с.64
- И.Романова.** Светодиодная продукция компании LG Innotek – высокая эффективность, низкое энергопотребление №6, с.74

СВЯЗЬ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

- А.Андреев, С.Гусев, С.Шумилин.** Ethernet-решения для специальной аппаратуры: отечественная элементная база №2, с.92
- С.Маргарян.** Радиомодемы Guardian – эффективная основа сетей обмена данными №6, с.134
- П.Сердюк, В.Слюсар.** Средства связи с наземными роботизированными системами: современное состояние и перспективы №7, с.66

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Н.Демкович.** Программный комплекс OOFELIE: Multiphysics – эффективный инструмент проектирования сложных систем №1, с.134
- А.Сабунин.** Программа Altium Designer 14 – новые возможности для проектирования печатных плат №1, с.138
- А.Курушин, К.Папилов.** Проектирование антенной решетки с помощью программы HFSS и CST MWS №2, с.98
- Г.Нанн, Ф.Дельгуст, А.Хан, А.Верма, Б.Геден.** Методы цифровой верификации для моделирования смешанных СНК в Synopsys VCS и CustomSim №3, с.118
- А.Курушин, Е.Лаврецкий, С.Чадов.** Расчет зеркальных параболических антенн с помощью современных САПР СВЧ №3, с.126
- А.Сабунин.** Работа в Altium Designer. Организация иерархических и многоканальных схем №4, с.132
- О.Воробьева, К.Кноп.** Torus 6.0. Шесть шагов навстречу №4, с.192

- С.Шумилин, А.Однолько, Р.Домбровский, М.Какоулин.** Платформа для создания ИМС, стойких к СВФ – полный набор компонентов №6, с.142
- А.Сергеев.** Orcad PCB Designer Standard. Редактор печатных плат для профессионалов №7, с.136
- Н.Кисель, С.Грищенко, Д.Дерачиц.** Проектирование фазовращателей – моделирование на базе САПР..... №8, с.148

СИСТЕМЫ СВЯЗИ

- А.Судаков.** Сверхширокополосные устройства – классификация и применение №3, с.98

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Н.Абрамов.** Новая серия AC-DC источников питания DRB от TDK-LAMBDA: компактность, универсальность и энергоэффективность №6, с.116
- А.Федоров.** Источники питания компании Mean Well – тенденции развития №6, с.122
- Д.Гудилин.** "Группа Кремний Эл": новая отечественная элементная база для силовой электроники №8, с.92
- Е.Рабинович.** TDK-Lambda: "Мы не стремимся к революции, а идем вперед" №8, с.98

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- В.Беляев.** Неделя дисплеев 2014 года. Большие достижения начинаются с малого №3, с.108

ТЕМА ГОДА: СВЧ

- Т.Сидорова, С.Дингес.** Компания Centellax – обзор продукции №1, с.151
- С.Дингес, Н.Егоров, В.Кочемасов.** Цифровые вычислительные синтезаторы для фазированных антенных решеток №1, с.160
- И.Викүлов.** GaN-микросхемы претендуют на замену ЭВЛ. Конкуренция обостряется №1, с.168
- Л.Белов.** Компания Akon. Ориентация на совершенство №1, с.176
- А.Багдасарян, С.Багдасарян, А.Кащенко, Г.Кащенко, Р.Семенов.** Системы радиочастотной идентификации. Методология формирования и выбора вариантов №1, с.184
- Д.Дитлиа, В.Горбачев, С.Хорев, В.Кувшинов.** Подстроечные пассивные компоненты ВЧ- и СВЧ-диапазона компании Sprague Goodman Electronics №1, с.190
- В.Шурыгина.** Радиочастотные МЭМС + КМОП. Отработанная технология, готовая к часу пик. Часть 1 №2, с.141
- В.Кочемасов, Д.Скок, А.Черкашин.** Цифровые вычислительные синтезаторы – современные решения №2, с.150
- К.Джурицкий.** Отечественные КМПЛ с предельной частотой 18 ГГц. Материалы, конструкции, технологии №2, с.162
- В.Шурыгина.** Радиочастотные МЭМС + КМОП. Отработанная технология, готовая к часу пик. Часть 2 №3, с.149
- А.Ткаченко.** Прямая цифровая модуляция: принципы и решения №3, с.162

- В.Горбачев, В.Кувшинов, С.Хорев.** Продукция компании SpectraTime: высокоточные опорные генераторы и эталоны времени №3, с.176
- В.Шурыгина.** "Чудо-материал" – графен. Новый конкурент на рынке РЧ-электроники. Часть 1 №4, с.141
- Н.Егоров.** Мощные СВЧ-устройства – решения компании Ferrite Microwave Technologies №4, с.150
- В.Кочемасов, Д.Скок, А.Черкашин.** Цифровые вычислительные синтезаторы – современные решения Часть 2 №4, с.154
- В.Шурыгина.** "Чудо-материал" – графен: новый конкурент на рынке РЧ-электроники. Часть 2 №5, с.151
- А.Евграфов.** ANSYS DesignerRF. Обзор возможностей №5, с.164
- В.Кувшинов, В.Кочемасов, В.Горбачев.** Устройства на основе ЖИГ-резонаторов – продукция компании Micro Lambda Wireless. Часть 1 №6, с.157
- А.Евграфов.** ANSYS HFSS. Передовые технологии трехмерного решения электродинамических задач №6, с.162
- С.Дингес, В.Кочемасов.** Логарифмические усилители – продукция компании AKON №7, с.107
- М.Гольцова.** TriQuint Semiconductor. Продвигаться дальше и быстрее №7, с.114
- В.Кочемасов, А.Голубков, Н.Егоров, А.Черкашин, А.Чугуй.** Цифровые вычислительные синтезаторы – применение в системах синтеза частот и сигналов №8, с.171
- В.Калинин, Н.Артемов, А.Коренчук.** Системы транспортной радиочастотной идентификации на основе пьезоэлектрических ПАВ-меток №8, с.180

ТЕХНОЛОГИИ – ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

- Ю.Богданов, В.Кочемасов, Е.Хасьянова.** Неорганические подложки. Характеристики, критерии выбора №2, с.204
- А.Петров.** Невозможное возможно. Автоматизация применения отечественных двухкомпонентных материалов №3, с.192
- М.Шейкин.** Гибкие печатные платы: теория и практика №5, с.200
- С.Фёдоров.** Современные технологии поверхностного монтажа для отечественных резисторов №6, с.192
- А.Зайцев.** Полеты наяву. Тестирование печатных плат методом "летающих щупов" №7, с.140
- Н.Иванов.** Повышение надежности поверхностного монтажа компонентов с шариковыми выводами в бессвинцовом исполнении №7, с.146
- А.Савельев.** Шесть вопросов об отмывке. Отвечает академия Zestron №7, с.158

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

- А.Бархударов.** Управление производством: от старых граблей до программируемой эффективности №3, с.186
- Д.Васильев.** Что, где и когда на производстве. Прослеживаемость в системе СМАРТ №5, с.110
- А.Мазалов.** Автоматизированное хранение документов №6, с.148

ЭКОНОМИКА+БИЗНЕС

В. Немудров, К. Борисов, Ю. Завалин, И. Корнеев, И. Малышев, В. Шиллер. Системы на кристалле и системы в корпусе. Новые возможности для военной техники	№1, с.144
М. Гольцова. Корпорация IBM. Крупнейшая за 20 лет реорганизация	№2, с.138
М. Кузьмин. Контрактное производство электроники в России: практический опыт компании "ДОЛОМАНТ"	№2, с.185
М. Макушин. Домаштабировались? Экономика уменьшения топологий	№3, с.134
М. Макушин. Производственная база мировой микроэлектроники: тенденции развития	№5, с.116
А. Андреев, С. Дашкевич, В. Евсеев, Г. Егоров, И. Наливкин. Отечественный рынок радиоэлектронной аппаратуры: анализ и выработка управленческих решений	№5, с.132
А. Трошин. Развитие инновационной экономики России в новых внешнеполитических условиях	№5, с.144
Ю. Носов, А. Сметанов. Крепить импортонезависимость страны!	№8, с.154
В. Евсеев, И. Наливкин. Импортозамещение ЭКБ и развитие радиоэлектроники. Обсуждение проблемы	№8, с.156
М. Макушин. Стратегия EU10/100/20: укрупнение и концентрация НИОКР в ЕС	№8, с.162

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ БАЗА ЭЛЕКТРОНИКИ

П. Чуприна. АЦП И ЦАП компании Maxim Integrated для промышленной электроники	№1, с.84
И. Романова. АЦП И ЦАП компании Fujitsu – новые технологии, высокая производительность	№1, с.96
А. Макарова. Новые АЦП и ЦАП компании NXP Semiconductors для радиочастотных устройств	№1, с.102
А. Балевики, К. Утюшев, М. Коротков. Новые устройства защиты оборудования от длительных перенапряжений	№1, с.108
А. Бекмачев. Инерциальные МЭМС-датчики и модули европейских производителей. Обзор новинок	№2, с.38
А. Новожилов, В. Ракитин, А. Сафонов. Тактильные датчики на полимерных материалах. Конструкции, технологии	№2, с.52
А. Большаков, И. Сердюк, М. Карякин. Газовая и пожарная безопасность. Сенсоры и приборы ОАО "Авангард"	№2, с.66
М. Павлюк, Ю. Сахно, В. Малых. Комплексное решение компании "Миландр" для учета потребления энергоресурсов	№2, с.78
И. Ермаков, Н. Шелепин. Конструктивные принципы реализации элементов ЭСППЗУ в КМОП-технологии	№2, с.82
Б. Сидоренко. Микроконтроллеры Atmel SAM D – Cortex-M0+: оптимальное соотношение производительности и энергоэффективности	№3, с.78

М. Павлюк, С. Козлов, Ю. Сахно, В. Малых. Счетчики электроэнергии. Модульная конструкция, низкая себестоимость	№3, с.88
В. Горбачев, В. Кочемасов, С. Хорев. Компания Gowanda Electronics. В ногу с техническим прогрессом	№3, с.94
М. Гольцова. Силовая полупроводниковая электроника. Многообещающие технологии становятся реальностью	№4, с.54
И. Романова. Индуктивные компоненты компании Murata для силовых и высокочастотных применений	№4, с.72
М. Павлюк, А. Коточигов, Ю. Сахно. Микроконтроллеры для счетчиков электроэнергии – современные решения	№4, с.84
А. Голощاپов. Энкодеры и датчики Zettlex – новый подход к измерению скоростей вращения и определения положения	№4, с.90
А. Гришанин, В. Елисеев, В. Мартыненко. Мощные диоды и тиристоры для преобразовательной техники нового поколения	№4, с.102
И. Лазер, Н. Иванов, В. Калинин. Физическая и химическая сенсорика микросистемотехники	№5, с.58
Ю. Агрич, В. Лишшиц. Новый АЦП компании "Миландр" – высокое быстродействие и малое энергопотребление	№5, с.66
А. Дёмин. API Technologies: одна компания – множество решений	№5, с.74
М. Павлюк, Л. Никитинский, Ю. Сахно. Многофункциональный счетчик на базе K1986BE21Y: перспективы развития	№6, с.84
И. Лазер, Н. Иванов, В. Калинин. Физическая и химическая сенсорика микросистемотехники. Часть 2	№6, с.90
А. Тузов. Радиационно-стойкая энергонезависимая память компании Northrop Grumman	№6, с.100
Н. Сакова. Соединительные системы Techplo. Сделано в Италии	№6, с.110
К. Джурицкий, Е. Покровский. Радиочастотные соединители: современное состояние	№7, с.28
М. Павлюк, А. Назаров, Ю. Сахно. Автоматизированный учет электроэнергии. Модули связи PLC и ZigBee	№7, с.38
А. Багдасарян, С. Багдасарян, Г. Карапетян, О. Машинин, Т. Синицына. Импедансные ПАВ-фильтры для телекоммуникационных систем. Российский приоритет	№7, с.48
М. Дидик. Российское производство магнитной наноэлектроники	№8, с.54
В. Майская. Системы памяти следующих поколений. Разрушение "стены памяти"	№8, с.58
И. Романова. Магниторезистивная память MRAM компании Everspin Technologies	№8, с.72
М. Шейкин. Запоминает быстро, помнит долго. Микросхемы памяти нового поколения Adesto Technologies	№8, с.80
М. Шейкин. NAND вместо NOR. Надежные решения компании Macronix	№8, с.86